

Title (en)
Installation for chemical dip treatment of metal pieces

Title (de)
Einrichtung für die chemische Tauchbehandlung von Metallstücken

Title (fr)
Installation de traitement chimique au trempé de pièces métalliques

Publication
EP 1205578 A1 20020515 (FR)

Application
EP 01402867 A 20011108

Priority
FR 0015038 A 20001108

Abstract (en)
An installation for the chemical treatment of metal components by immersion in a tank (9, 11) containing a chemical treatment bath, the components being submitted to a prior preparation treatment and a finishing treatment in other tanks, consists of the different treatment tanks being arranged in two parallel lines separated by an alley (3) allowing access to the tanks. A first line (1) incorporates a charging/discharging device (4) at one of its ends along with the preparation tanks (5 - 8, 10) whilst a second line (2) incorporates two chemical treatment tanks (9, 11), functioning alternately, and some finishing tanks (14 - 18). A longitudinal transfer manipulator is provided for each line and a transverse transfer device is provided to connect the two lines.

Abstract (fr)
Installation de traitement chimique au trempé par immersion dans une cuve (9, 11) contenant un bain de traitement chimique, les pièces étant soumises à un traitement de préparation préalable et à un traitement de finissage ultérieur dans d'autres cuves, caractérisée en ce que les différentes cuves de traitement sont disposées sur deux lignes parallèles séparées par une allée (3) permettant l'accès aux cuves. Une première ligne (1) comporte un dispositif de chargement/déchargement (4) à une de ses extrémités, ainsi que des cuves de préparation (5-8, 10). Une deuxième ligne (2) comporte deux cuves de traitement chimique (9, 11), fonctionnant en alternance, et des cuves de finissage (14-18). Un manipulateur de transfert longitudinal est prévu dans chaque ligne et l'on prévoit des moyens de transfert transversal assurant la liaison entre les deux lignes (1, 2), en sens aller et en sens retour. <IMAGE>

IPC 1-7
C23C 22/00

IPC 8 full level
C23C 22/00 (2006.01)

CPC (source: EP)
C23C 22/00 (2013.01)

Citation (search report)
[A] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 008, no. 085 (C - 219) 18 April 1984 (1984-04-18)

Cited by
CN109898075A; CN115044893A

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE TR

DOCDB simple family (publication)
EP 1205578 A1 20020515; EP 1205578 B1 20100818; AT E478170 T1 20100915; DE 60142823 D1 20100930; FR 2816326 A1 20020510; FR 2816326 B1 20030418

DOCDB simple family (application)
EP 01402867 A 20011108; AT 01402867 T 20011108; DE 60142823 T 20011108; FR 0015038 A 20001108